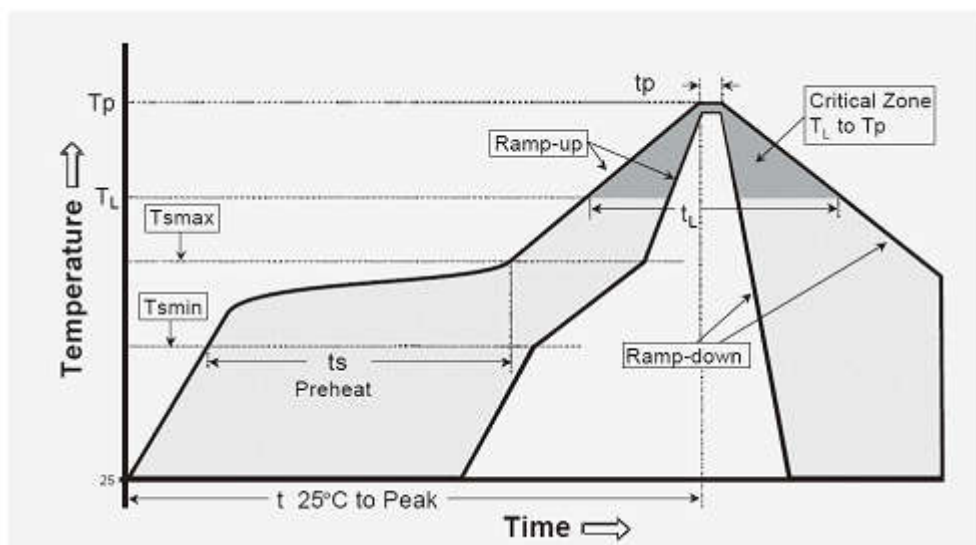


回流焊温度曲线

我们建议在回流焊温度曲线设定时，遵从 IPC 相关标准，并根据锡膏的实际曲线进行设置：



IPC/JEDEC J-STD-020B 无铅回流焊条件	适用大尺寸零件（厚度≥2.5mm）
升温速率（Tl 到 Tp）	3°C/秒（最大）
预热温度 - 下限温度（Tsmín） - 上限温度（Tsmáx） - 预热时间（ts）	150°C 200°C 60~180 秒
预热到峰值温度升温速率	3°C/秒（最大）
焊接时间	

— 焊接温度	217℃
— 熔点以上时间	60~150 秒
峰值温度	245+/-5℃
峰值温度+/-℃范围焊接时间	10~30 秒
降温速率	6℃/秒（最大）
全程焊接时间	8 分钟（最大）

注意事项

——无铅焊接材料的润湿性较锡铅共晶材料差，融熔区温度较高，为达到更好的焊接效果，保护焊接点不氧化，回流焊时请使用氮气保护；

——在必须对模块进行焊接翻修时，我们建议使用手动焊接，避免多次回流焊接工艺对模块造成可能的损坏；

其它

客户应根据生产实际情况，制定符合以上提示的焊接工艺。